

Forum zu digitaler Bahn- und Schienentechnik für Asien in Manila

 10.04.2019

Asiatische Entwicklungsbank lädt Experten vom 21. bis 24. Mai 2019 ein

Bonn (GTAI) - Bis zum 12. April 2019 können sich Firmen für die Teilnahme an einem Railway Industry Day im Rahmen des Forums bewerben.

Der Stand der Bahninfrastruktur in Asien ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Neue digitale Technologien eröffnen viele Möglichkeiten, stellen Entscheidungsträger aber auch vor die Herausforderung, die geeignetsten auszuwählen. Das Asia-Pacific Railway Innovations Forum in Manila stellt digitale Neuerungen für die Bahn- und Schieneninfrastruktur vor und ermöglicht die Diskussion zwischen Vertretern aus Politik und Industrie und Fachorganisationen. Veranstalter sind die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) und die International Union of Railways (UIC). Themen des Forums sind unter anderem Big Data für das Asset-Management von Bahninfrastruktur, Trends in der Eisenbahnsignaltechnik, regionale Initiativen, Smart Stations und Eisenbahnsicherheit. Am 23. Mai 2019 findet im Rahmen des Forums der Railway Industry Day statt, auf dem Unternehmen ihre Technologien vorstellen können. Hierfür ist eine gesonderte Anmeldung notwendig.

Kontaktadresse

Bezeichnung	Internetadresse	Anmerkungen
Internetseite des Railway Innovations Forum mit Programm und Anmeldung	https://www.adb.org/news/events/railway-innovations-forum-2019 ▶	Für die Anmeldung zum Railway Industry Day bitte die Information Note zum Bewerbungsprozedere beachten.

(DONE)

KONTAKT

Dorothea Netz

☎ +49 228 24 993 339

✉ [Ihre Frage an uns](#)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2019 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.